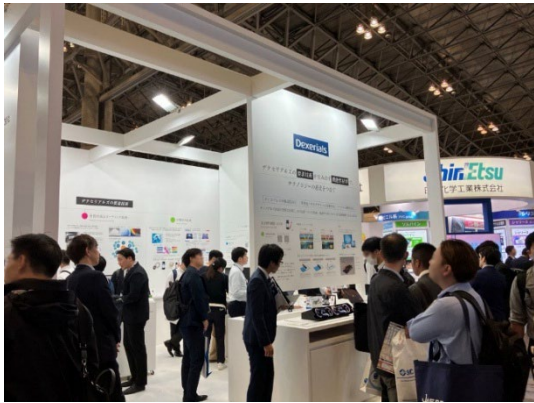


2025 年 10 月 9 日
デクセリアルズ株式会社

第 16 回 フィルムテックジャパン（高機能フィルム展）に出展

デクセリアルズ株式会社（本社：栃木県下野市、代表取締役社長：新家 由久、以下、当社）は、このたび、2025 年 11 月 12 日（水）から 14 日（金）に、幕張メッセ（千葉県）で開催される「第 16 回 フィルムテックジャパン（高機能フィルム展）」に出展することをお知らせします。



昨年の出展の様子



今年の当社ブースイメージ

2012 年に事業を開始した当社※1 は、経営理念「Integrity 誠心誠意・真摯であれ」を掲げ、常に「今までなかったもの」に挑戦し、時代や技術の変化を先回りした製品開発によりテクノロジーの進化を支えてきました。現在は、スマートフォンやノートパソコンをはじめとするエレクトロニクス機器、電装化が進む自動車に欠かせない電子部品、接合材料や光学材料など機能性材料の開発・製造・販売を手掛け、国内 8(子会社拠点含む)、海外 11 の製造・販売拠点で事業を展開しています。

今回、当社のブース（展示ホール 1 5 - 60）では、高度な技術で製造され世界 No.1※2 シェアを獲得した「反射防止フィルム（ARF）」や、ディスプレイの視認性を向上させる「光学弾性樹脂（SVR）」、IT 製品の小型化・高機能化に対応する「異方性導電膜（ACF）」など、お客さまの課題解決に貢献するソリューションをはじめ、当社の要素技術として、有機樹脂配合技術、微細加工技術を紹介します。

また、当社技術に関するショートプレゼンテーションを行う予定です。展示詳細は、下記のとおりです。

記

- ・展示会名 : 第 16 回 フィルムテックジャパン（高機能フィルム展）
- ・会期 : 2025 年 11 月 12 日（水）～14 日（金）10:00～18:00（最終日のみ 17:00 終了）
- ・会場 : 幕張メッセ（千葉県）デクセリアルズブース：展示ホール 1 5-60
- ・出展予定製品：反射防止フィルム（ARF）、反射防止フィルム モスアイタイプ、異方性導電膜（ACF）、光学弾性樹脂（SVR）、拡散マイクロレンズアレイなど
※展示製品は変更となる場合があります。ご了承ください。
- ・参加方法 : 下記公式ウェブサイトの入場登録ページより事前登録のうえご来場ください。

<https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1468140263056506-ZYY>

デクセリアルズは、これからも、社会課題の解決を支えるデジタル・テクノロジーの進化に不可欠な高付加価値製品、技術・ソリューションを提供することで、持続可能な社会の実現への貢献と、持続的成長、そして、さらなる企業価値向上に努めてまいります。

※1 2012 年にソニーケミカル&インフォメーションデバイス株式会社よりデクセリアルズ株式会社に社名変更し、事業を開始。

※2 以下の 3 製品で世界トップシェア。

- ・スパッタリング技術で製造された反射防止フィルム：株式会社富士キメラ総研発行「2025 ディスプレイ関連市場の現状と将来展望」による、表面処理フィルム（ドライコート）の 2024 年の金額シェア。
- ・光学弾性樹脂（SVR）：株式会社富士キメラ総研発行「2025 ディスプレイ関連市場の現状と将来展望」による、ディスプレイの貼り合わせで使用する光学透明接着剤（OCR/LOCA）の 2024 年の金額シェア。光学弾性樹脂（SVR）は、光学透明接着剤の当社製品名です。
- ・異方性導電膜（ACF）：株式会社富士キメラ総研発行「2025 ディスプレイ関連市場の現状と将来展望」による、大型および中小型ディスプレイ向け ACF の合計の 2024 年の金額シェア。

以 上

1. 出展内容について

スマートフォンやカメラ、センサー、ディスプレイ、AR/VR など進化する IT 製品に欠かせない製品を展示します。数多くの開発品などを出展しており、社会課題の解決に貢献する製品・ソリューションをご提案します。

2. 初出展の展示について

① 3層 CCL 用低誘電接着フィルム

さまざまな環境下で安定した低誘電特性を示す高速伝送用基板向け層間接着シート。

難接着で知られる高周波部材（LCP、Modified-PI、低粗度銅箔）への高い接着信頼性、耐熱性を発揮。またビア加工性に優れる。

② リフロー対応工程用保護テープ

さまざまな形状に加工が可能で、工程で発生する異物などから製品を保護するテープ。

耐熱性に優れ、無鉛リフロー工程（ピーク 260℃）を通して対象物への糊残りなくテープを剥離することが可能。

③ フィルム型はんだ実装材料

現在開発中の、はんだペーストを代替する熱硬化フィルム。

はんだリフロープロセスを使って、0.25mm ピッチの BGA など狭ピッチな外部端子を持つ電子部品の実装に対応。

3. ショートプレゼンテーション実施について

- ・テーマ：微細加工技術、異方性導電膜（ACF）、接着剤、ブース見どころガイド
- ・開催日時：会期時間内で各回 10 分。詳細スケジュールは、当日デクセリアルズブース正面モニター前に掲示する開催スケジュール表をご覧ください。
- ・会場：「デクセリアルズブース」内正面モニター前
- ・参加方法：お時間が近くなりましたら正面モニター近くに集まり下さい。
立ち見でのご案内になります。

4. 展示会概要

展示会名称：第 16 回 フィルムテックジャパン（高機能フィルム展）
会期：2025 年 11 月 12 日（水）～14 日（金） 10:00～18:00（最終日のみ 17:00 終了）
会場：幕張メッセ（千葉県）
主催：RX Japan 株式会社
展示会概要：機能性フィルムの成形加工技術や材料、機能性フィルムそのものが一堂に出展する世界最大規模の展示会です。フィルムメーカーの技術部門をはじめ、エレクトロニクス、自動車、電池、建築・建材、食品・飲料などさまざまな分野で機能性フィルムを求める専門家が来場し、出展社と活発な商談を行っています。

公式ウェブサイト：<https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit/film.html>

<会社概要>

当社は、スマートフォンやノートパソコンをはじめとするエレクトロニクス機器、電装化が進む自動車に欠かせない電子部品、接合材料や光学材料など機能性材料の開発・製造・販売を手掛けています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（[経営理念と企業ビジョン、パーパス | 会社情報 | デクセリアルズ株式会社 \(dexterials.jp\)](#)）としてかかげています。

会社名：デクセリアルズ株式会社

本社：栃木県下野市下坪山 1724

代表者：代表取締役社長 新家 由久

設立：2012 年 6 月 20 日

公式ウェブサイト：<https://www.dexterials.jp/>